

英飞凌CoolSiC™ 混合单管 - TRENCHSTOP™ 5 H5 IGBT

与半额定值第六代 CoolSiC™ 二极管共同封装

特性

- $V_{CE} = 650\text{ V}$
- $I_C = 40\text{ A}$
- TRENCHSTOP™ 5 与 CoolSiC™ 技术以及开尔文发射器引脚相结合，实现超低开关损耗
- 硬开关拓扑中的基准效率
- 即插即用，替代纯硅器件
- 优化的四引脚封装引脚布局简化了 PCB 设计
- 开尔文发射器和栅极引脚的间隙增大，提高了波峰焊质量
- 最高结温 $T_{vjmax} = 175^\circ\text{C}$
- 符合 JEDEC 目标应用要求
- 无铅镀层；符合 RoHS 标准
- 完整的产品品类和 PSpice 模型：<http://www.infineon.com/igbt/>

潜在应用

- 工业开关电源
- 工业级不间断电源 (UPS)
- 光伏组串逆变器
- 储能
- 充电器

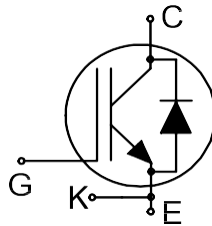
产品验证

- 根据 JEDEC20/22 相关测试的测试条件，符合上述应用要求

描述

封装引脚定义：

- 引脚 C & 背面 - 集电极
- 引脚 E - 发射极
- 引脚 K - 开尔文发射极
- 引脚 G - 栅极



Type	Package	Marking
IKZA40N65RH5	PG-TO247-4-3	K40ERH5

目录

	描述	1
	特性	1
	潜在应用.....	1
	产品验证.....	1
	目录	2
1	封装	3
2	IGBT	3
3	二极管.....	6
4	特性图.....	7
5	封装外形.....	13
6	测试条件.....	14
	修订记录	15
	免责声明.....	16

1封装

1 封装

表1 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Internal emitter inductance measured 5 mm (0.197 in.) from case	L_E			13.0		nH
Storage temperature	T_{stg}		-55		150	°C
Soldering temperature		wave soldering 1.6 mm (0.063 in.) from case for 10 s			260	°C
Mounting torque	M	M3 screw Maximum of mounting process: 3			0.6	Nm
Thermal resistance, junction-ambient	$R_{th(j-a)}$				40	K/W

2 IGBT

表2 最大额定值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Collector-emitter voltage	V_{CE}	$T_{vj} \geq 25\text{ °C}$		650		V
DC collector current, limited by T_{vjmax}	I_C		$T_c = 25\text{ °C}$	74		A
			$T_c = 100\text{ °C}$	46		
Pulsed collector current, t_p limited by T_{vjmax}	I_{Cpulse}			160		A
Turn-off safe operating area		$V_{CE} \leq 650\text{ V}$, $t_p = 1\text{ }\mu\text{s}$, $T_{vj} \leq 175\text{ °C}$		160		A
Gate-emitter voltage	V_{GE}			± 20		V
Transient gate-emitter voltage	V_{GE}	$t_p \leq 10\text{ }\mu\text{s}$, $D < 0.01$		± 30		V
Power dissipation	P_{tot}		$T_c = 25\text{ °C}$	250		W
			$T_c = 100\text{ °C}$	125		

表3 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit	
			Min.	Typ.	Max.		
Collector-emitter saturation voltage	V_{CEsat}	$I_C = 40\text{ A}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		1.65	2.1	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		1.85		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		1.95		
Gate-emitter threshold voltage	V_{GETh}	$I_C = 0.4\text{ mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$	3.2	4	4.8	V	

(表格续下页.....)

表 3 (续) 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition		Values			Unit
				Min.	Typ.	Max.	
Zero gate-voltage collector current	I_{CES}	$V_{CE} = 650 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$			600	μA
			$T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$		2000		
Zero gate-voltage collector current	I_{CES}	$V_{CE} = 480 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$			16	μA
Gate-emitter leakage current	I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}$				100	nA
Transconductance	g_{fs}	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 20 \text{ V}$			50		S
Input capacitance	C_{ies}	$V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}, f = 250 \text{ kHz}$			2190		pF
Output capacitance	C_{oes}	$V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}, f = 250 \text{ kHz}$			265		pF
Reverse transfer capacitance	C_{res}	$V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}, f = 250 \text{ kHz}$			8		pF
Gate charge	Q_G	$I_C = 40 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}, V_{CC} = 520 \text{ V}$			95		nC
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{CC} = 400 \text{ V}, V_{GE} = 0/15 \text{ V}, R_{Gon} = 15 \text{ } \Omega, R_{Goff} = 15 \text{ } \Omega, L_\sigma = 30 \text{ nH}, C_\sigma = 30 \text{ pF}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}, I_C = 20 \text{ A}$		17		ns
			$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}, I_C = 5 \text{ A}$		17		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}, I_C = 20 \text{ A}$		18		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}, I_C = 5 \text{ A}$		16		
Rise time (inductive load)	t_r	$V_{CC} = 400 \text{ V}, V_{GE} = 0/15 \text{ V}, R_{Gon} = 15 \text{ } \Omega, R_{Goff} = 15 \text{ } \Omega, L_\sigma = 30 \text{ nH}, C_\sigma = 30 \text{ pF}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}, I_C = 20 \text{ A}$		7		ns
			$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}, I_C = 5 \text{ A}$		4		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}, I_C = 20 \text{ A}$		7		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}, I_C = 5 \text{ A}$		3		
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$	$V_{CC} = 400 \text{ V}, V_{GE} = 0/15 \text{ V}, R_{Gon} = 15 \text{ } \Omega, R_{Goff} = 15 \text{ } \Omega, L_\sigma = 30 \text{ nH}, C_\sigma = 30 \text{ pF}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}, I_C = 20 \text{ A}$		165		ns
			$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}, I_C = 5 \text{ A}$		190		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}, I_C = 20 \text{ A}$		195		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}, I_C = 5 \text{ A}$		240		

(表格续下页.....)

表 3 (续) 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit	
			Min.	Typ.	Max.		
Fall time (inductive load)	t_f	$V_{CC} = 400\text{ V}, V_{GE} = 0/15\text{ V},$ $R_{Gon} = 15\ \Omega, R_{Goff} = 15\ \Omega,$ $L_{\sigma} = 30\text{ nH}, C_{\sigma} = 30\text{ pF}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C},$ $I_C = 20\text{ A}$		13		ns
			$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}, I_C = 5\text{ A}$		25		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C},$ $I_C = 20\text{ A}$		22		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C},$ $I_C = 5\text{ A}$		35		
Turn-on energy	E_{on}	$V_{CC} = 400\text{ V}, V_{GE} = 0/15\text{ V},$ $R_{Gon} = 15\ \Omega, R_{Goff} = 15\ \Omega,$ $L_{\sigma} = 30\text{ nH}, C_{\sigma} = 30\text{ pF}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C},$ $I_C = 20\text{ A}$		0.14		mJ
			$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}, I_C = 5\text{ A}$		0.03		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C},$ $I_C = 20\text{ A}$		0.16		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C},$ $I_C = 5\text{ A}$		0.04		
Turn-off energy	E_{off}	$V_{CC} = 400\text{ V}, V_{GE} = 0/15\text{ V},$ $R_{Gon} = 15\ \Omega, R_{Goff} = 15\ \Omega,$ $L_{\sigma} = 30\text{ nH}, C_{\sigma} = 30\text{ pF}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C},$ $I_C = 20\text{ A}$		0.12		mJ
			$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}, I_C = 5\text{ A}$		0.05		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C},$ $I_C = 20\text{ A}$		0.22		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C},$ $I_C = 5\text{ A}$		0.07		
Total switching energy	E_{ts}	$V_{CC} = 400\text{ V}, V_{GE} = 0/15\text{ V},$ $R_{Gon} = 15\ \Omega, R_{Goff} = 15\ \Omega,$ $L_{\sigma} = 30\text{ nH}, C_{\sigma} = 30\text{ pF}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C},$ $I_C = 20\text{ A}$		0.26		mJ
			$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}, I_C = 5\text{ A}$		0.08		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C},$ $I_C = 20\text{ A}$		0.38		
			$T_{vj} = 150\text{ }^{\circ}\text{C},$ $I_C = 5\text{ A}$		0.11		
IGBT thermal resistance, junction-case	$R_{th(j-c)}$				0.6		K/W
Operating junction temperature	T_{vj}		-40		175		$^{\circ}\text{C}$

3 二极管

表4 最大额定值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values	Unit	
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	$T_{vj} \geq 25\text{ °C}$	650	V	
Diode forward current, limited by T_{vjmax}	I_F		$T_c = 25\text{ °C}$	27.5	A
			$T_c = 100\text{ °C}$	18.5	
Diode pulsed current, t_p limited by T_{vjmax} ¹⁾	I_{Fpulse}		60	A	

1) 脉冲电流水平取决于二极管芯片的 T_{vj} ，另见图“最大脉冲电流与结温的关系”

表5 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 16\text{ A}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.35	1.5	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.55		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	1.65		
Diode thermal resistance, junction-case	$R_{th(j-c)}$				1.8	K/W
Operating junction temperature	T_{vj}		-40		175	°C

注意：为了获得最佳的使用寿命和可靠性，英飞凌建议运行条件不超过本数据手册中所述最大额定值的80%。

除非另有规定，电气特性均为 $T_{vj} = 25\text{ °C}$ 。

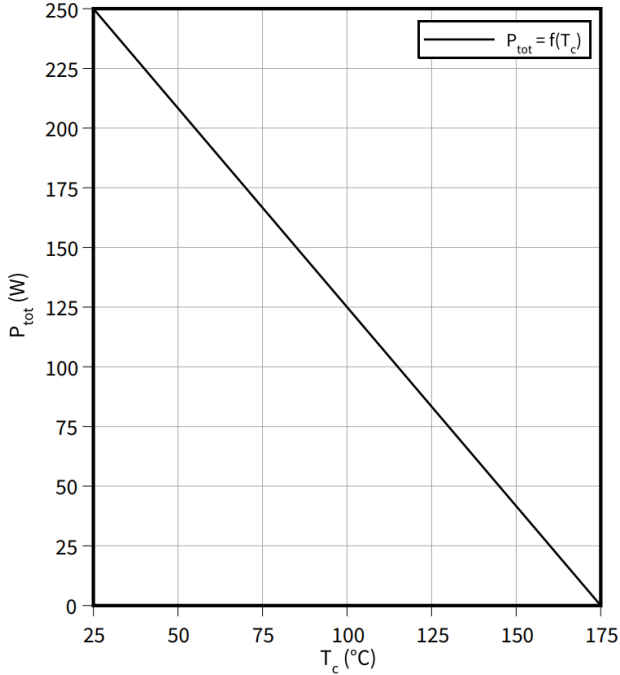
动态测试电路，寄生电感 L_σ ，寄生电容 C_σ ，来自图E。能量损失包括“拖尾”和二极管反向恢复。

4 特性图

4 特性图

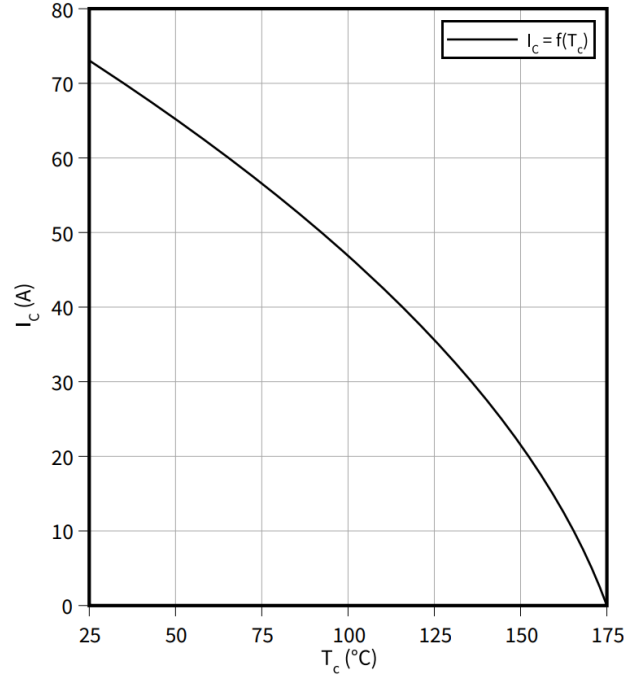
Power dissipation as a function of case temperature

$P_{tot} = f(T_c)$
 $T_{vj} \leq 175\text{ °C}$



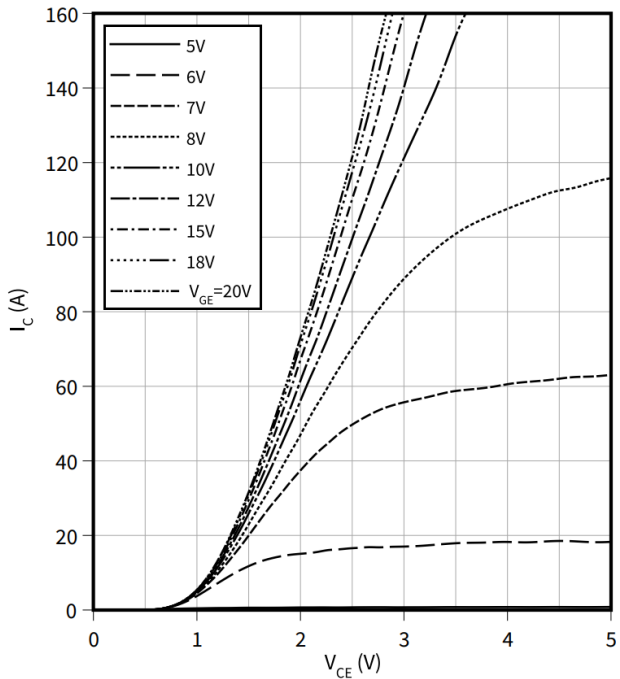
Collector current as a function of case temperature

$I_C = f(T_c)$
 $T_{vj} \leq 175\text{ °C}, V_{GE} \geq 15\text{ V}$



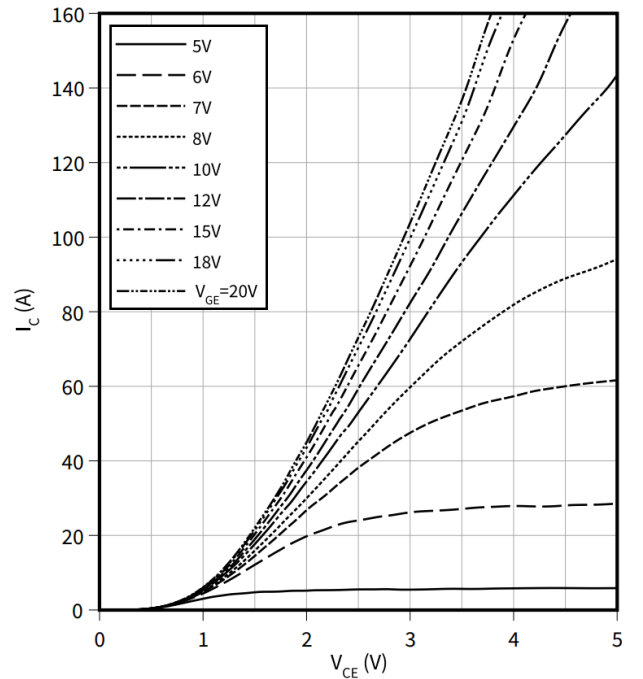
Typical output characteristic

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 25\text{ °C}$



Typical output characteristic

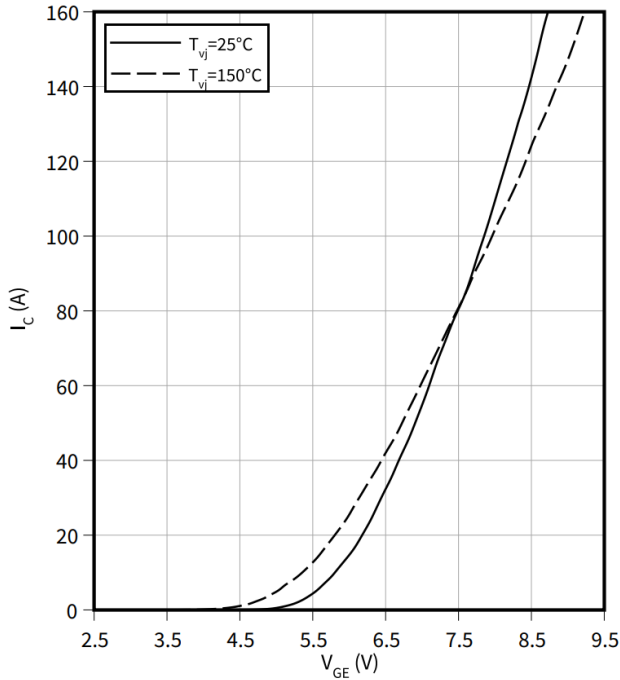
$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150\text{ °C}$



4 特性图

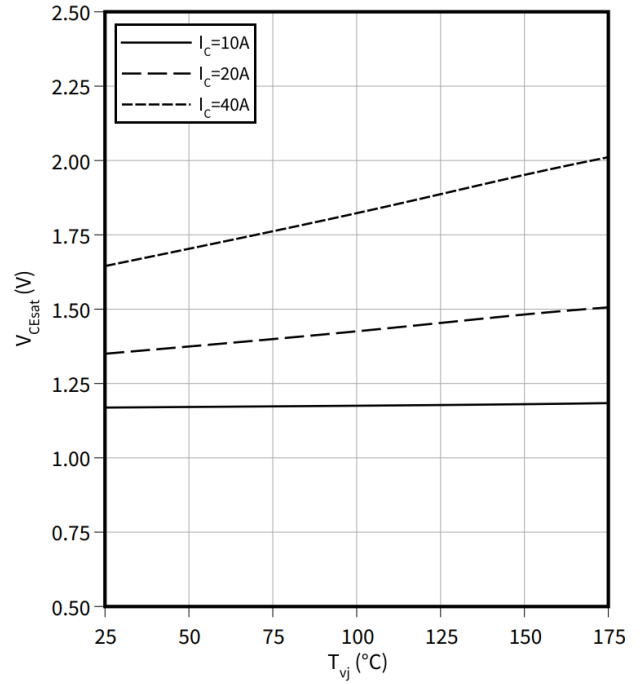
Typical transfer characteristic

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



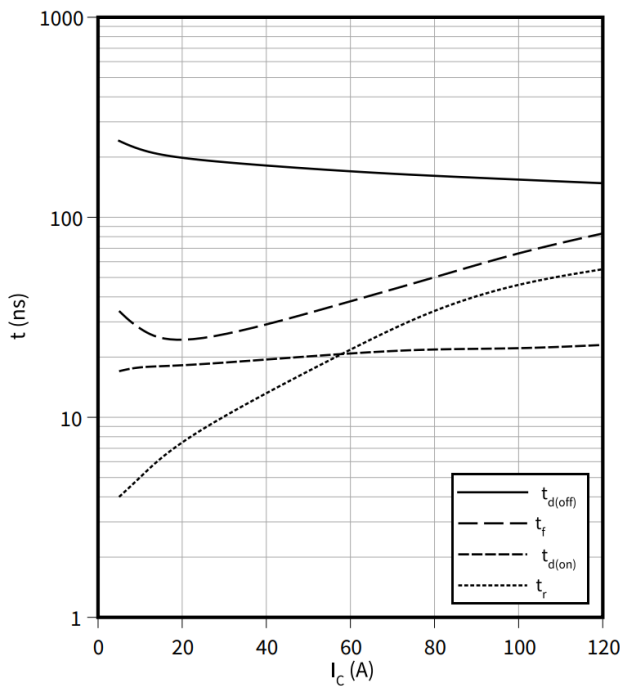
Typical collector-emitter saturation voltage as a function of junction temperature

$V_{CEsat} = f(T_{vj})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



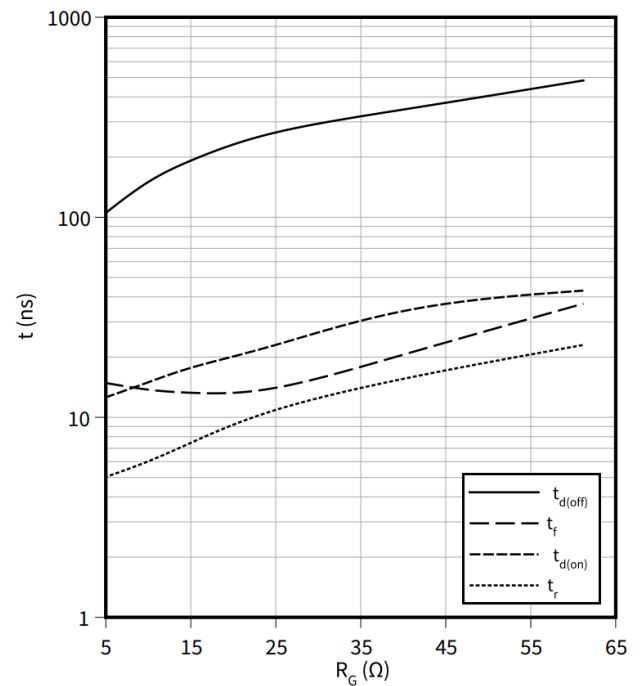
Typical switching times as a function of collector current

$t = f(I_C)$
 $V_{CC} = 400\text{ V}$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$, $V_{GE} = 0/15\text{ V}$, $R_G = 15\ \Omega$



Typical switching times as a function of gate resistor

$t = f(R_G)$
 $I_C = 20\text{ A}$, $V_{CC} = 400\text{ V}$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$, $V_{GE} = 0/15\text{ V}$

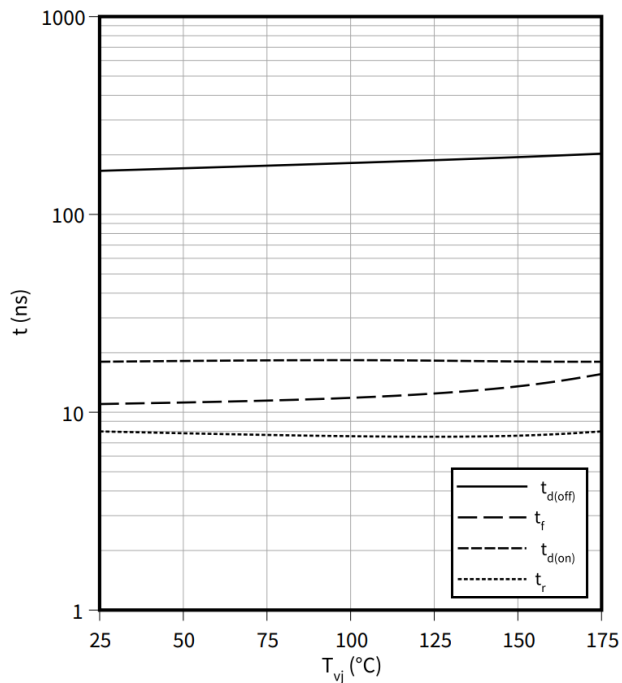


4 特性图

Typical switching times as a function of junction temperature

$t = f(T_{vj})$

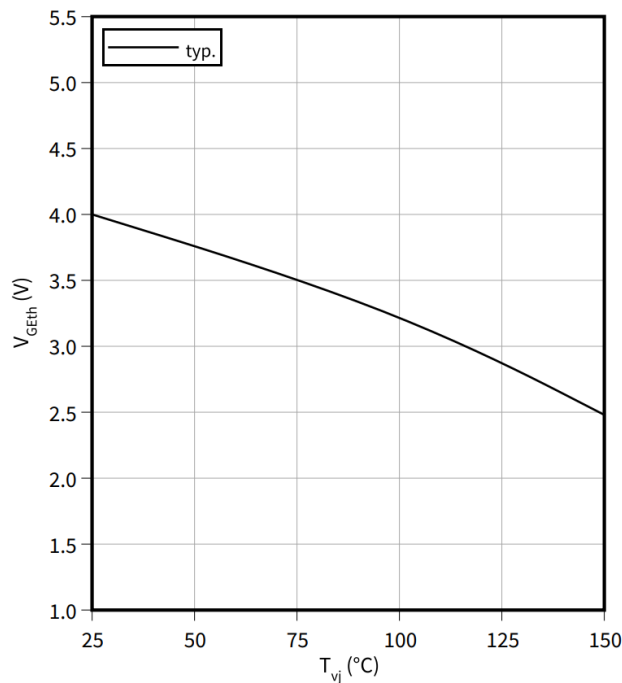
$I_C = 20 \text{ A}$, $V_{CC} = 400 \text{ V}$, $V_{GE} = 0/15 \text{ V}$, $R_G = 15 \Omega$



Gate-emitter threshold voltage as a function of junction temperature

$V_{GEth} = f(T_{vj})$

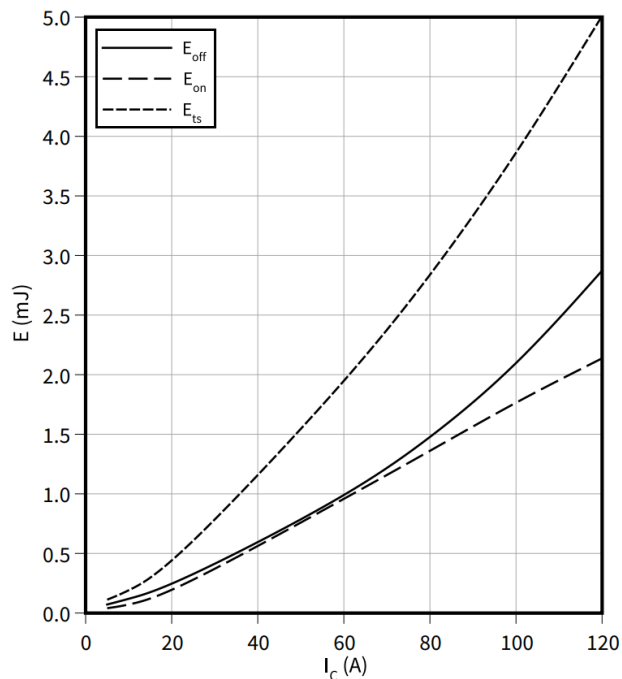
$I_C = 0.4 \text{ mA}$



Typical switching energy losses as a function of collector current

$E = f(I_C)$

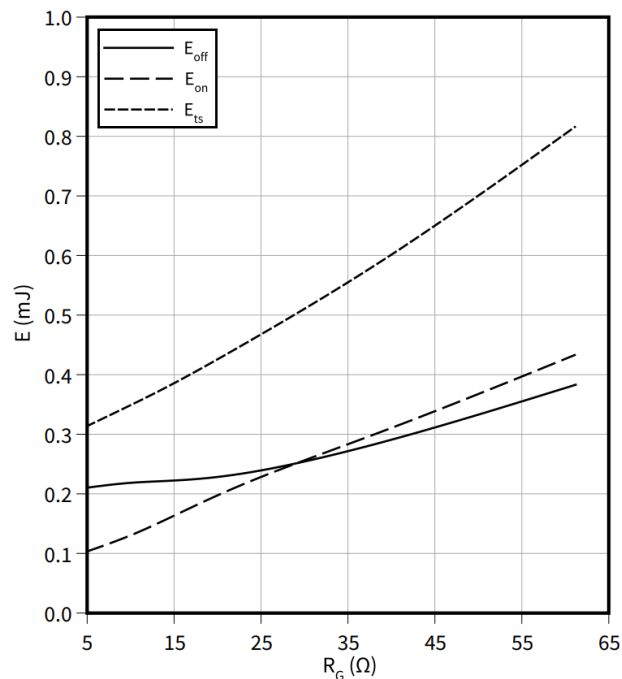
$V_{CC} = 400 \text{ V}$, $T_{vj} = 150 \text{ °C}$, $V_{GE} = 0/15 \text{ V}$, $R_G = 15 \Omega$



Typical switching energy losses as a function of gate resistor

$E = f(R_G)$

$I_C = 20 \text{ A}$, $V_{CC} = 400 \text{ V}$, $T_{vj} = 150 \text{ °C}$, $V_{GE} = 0/15 \text{ V}$

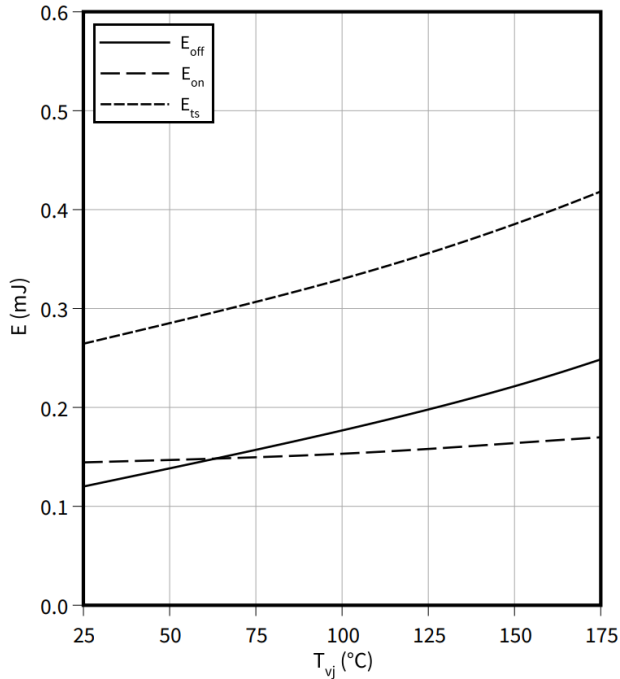


4 特性图

Typical switching energy losses as a function of junction temperature

$E = f(T_{vj})$

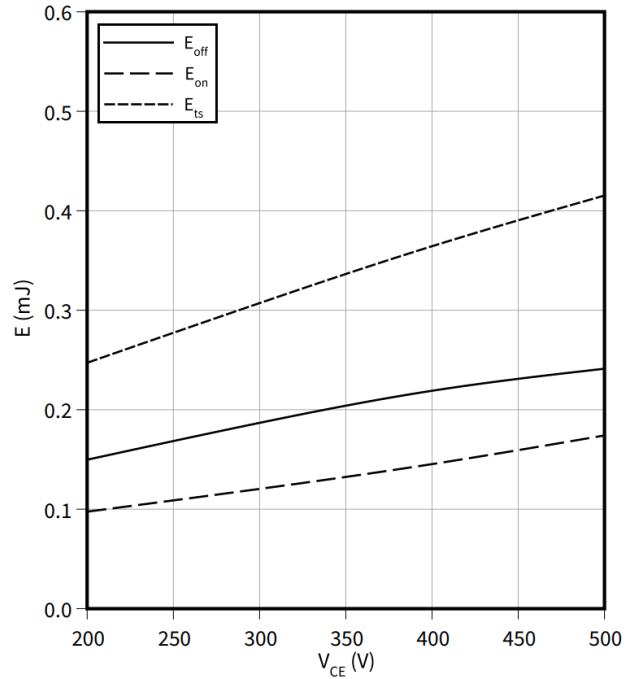
$I_C = 20\text{ A}$, $V_{CC} = 400\text{ V}$, $V_{GE} = 0/15\text{ V}$, $R_G = 15\ \Omega$



Typical switching energy losses as a function of collector emitter voltage

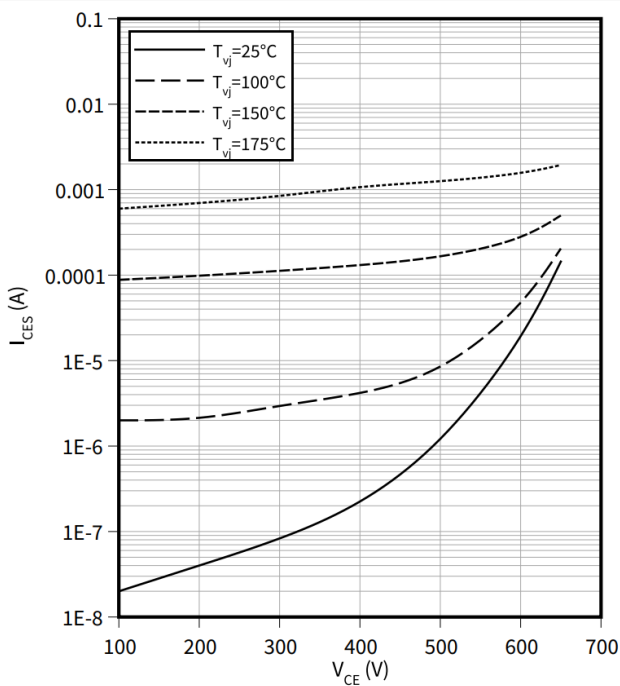
$E = f(V_{CE})$

$I_C = 20\text{ A}$, $T_{vj} = 150\text{ °C}$, $V_{GE} = 0/15\text{ V}$, $R_G = 15\ \Omega$



Typ. reverse current vs. reverse voltage as a function of T_{vj}

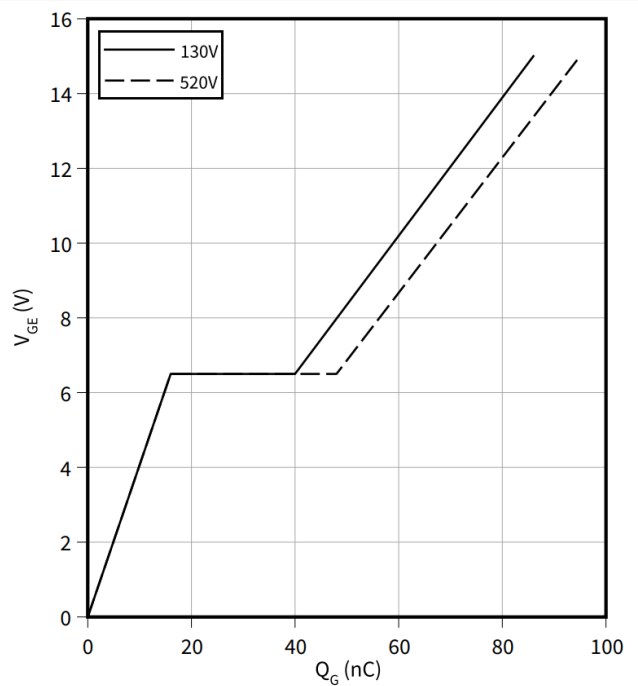
$I_{CES} = f(V_{CE})$



Typical gate charge

$V_{GE} = f(Q_G)$

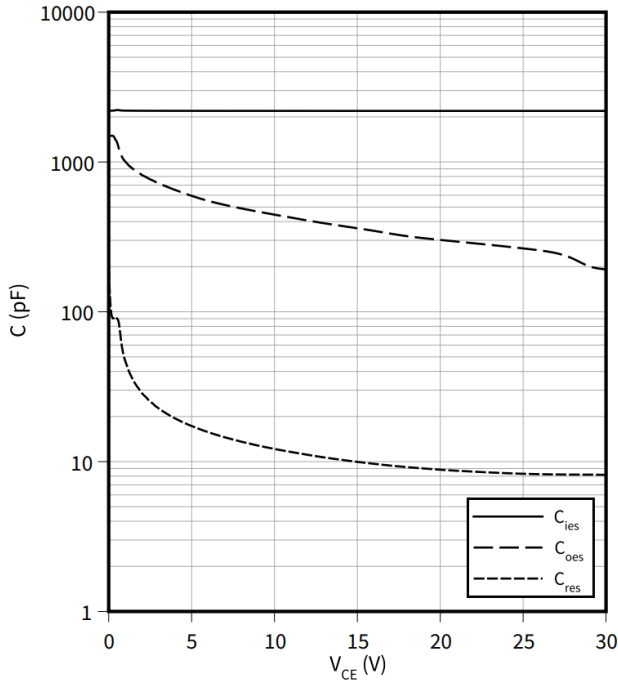
$I_C = 40\text{ A}$



4 特性图

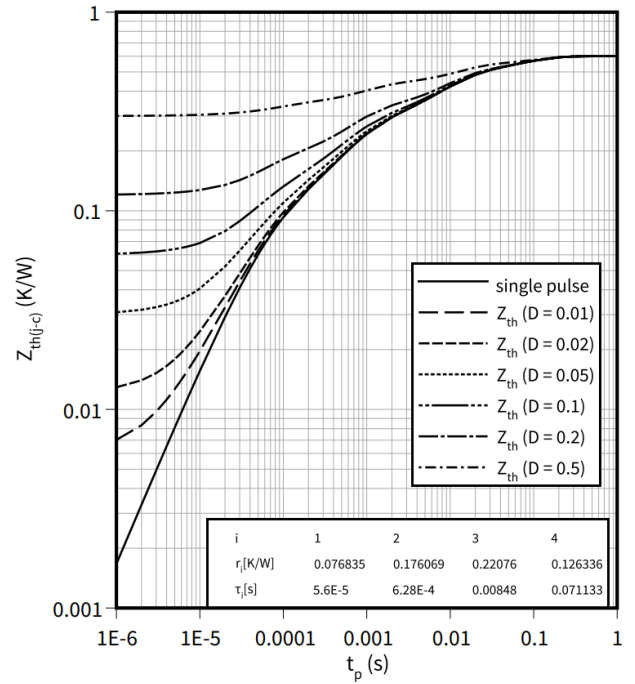
Typical capacitance as a function of collector-emitter voltage

$C = f(V_{CE})$
 $f = 250 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}$



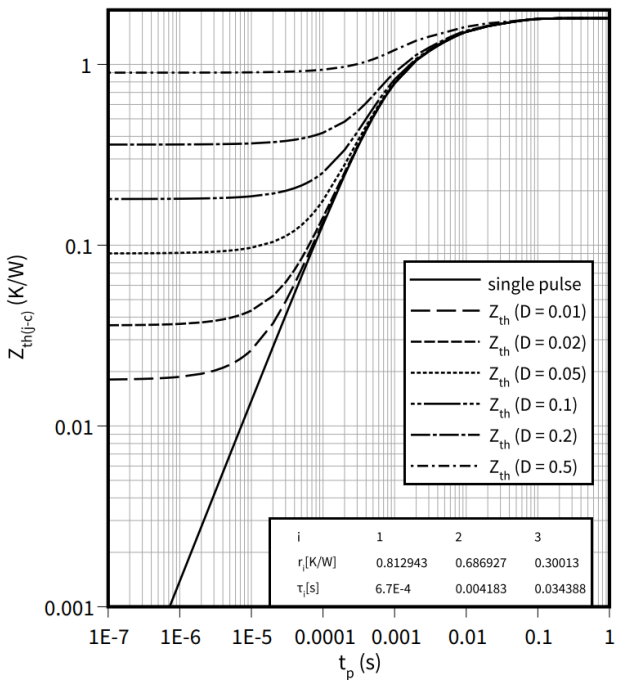
IGBT transient thermal impedance as a function of pulse width

$Z_{th(j-c)} = f(t_p)$
 $D = t_p/T$



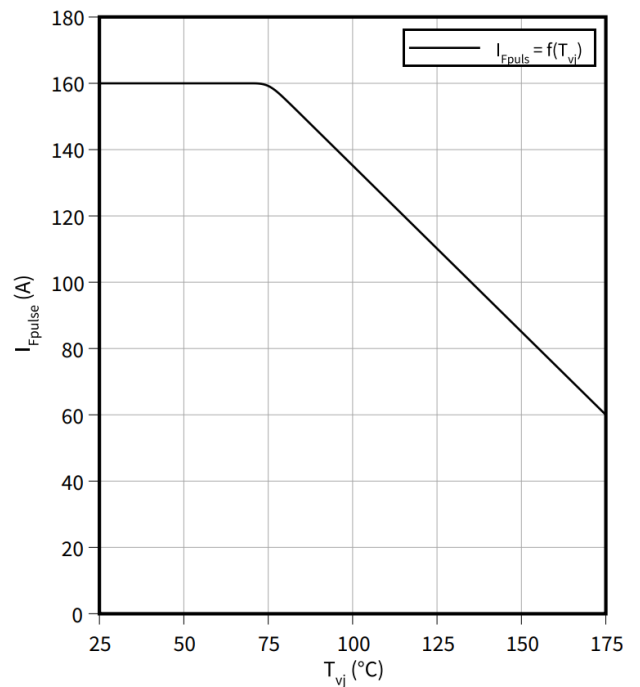
Diode transient thermal impedance as a function of pulse width

$Z_{th(j-c)} = f(t_p)$
 $D = t_p/T$



Maximum pulse current as a function of junction temperature

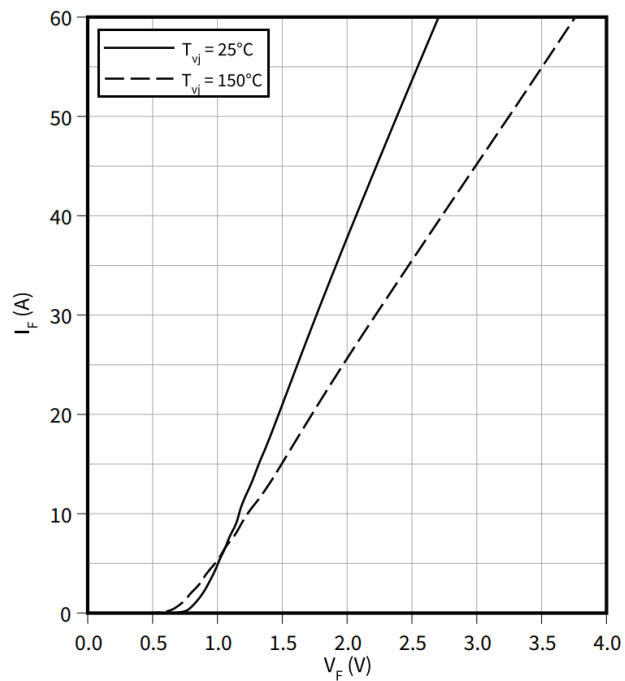
$I_{Fpulse} = f(T_{vj})$



4 特性图

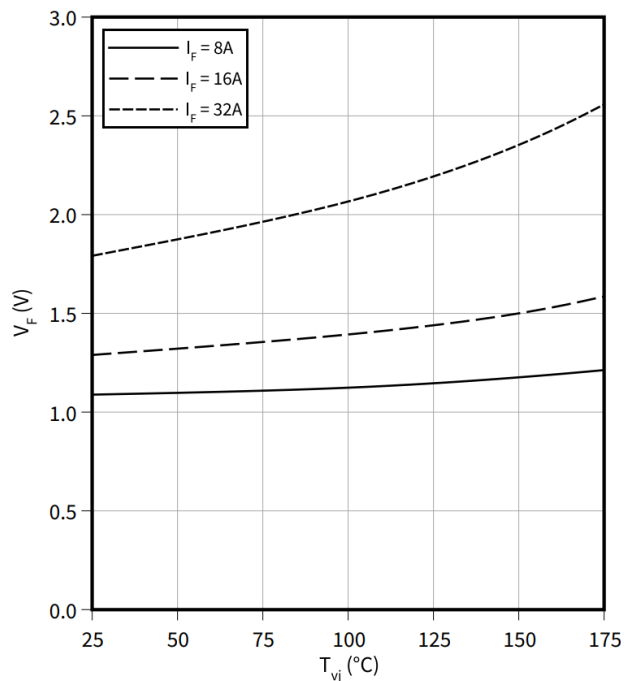
Typical diode forward current as a function of forward voltage

$I_F = f(V_F)$



Typical diode forward voltage as a function of junction temperature

$V_F = f(T_{vj})$



5 封装外形

PG-TO247-4-3

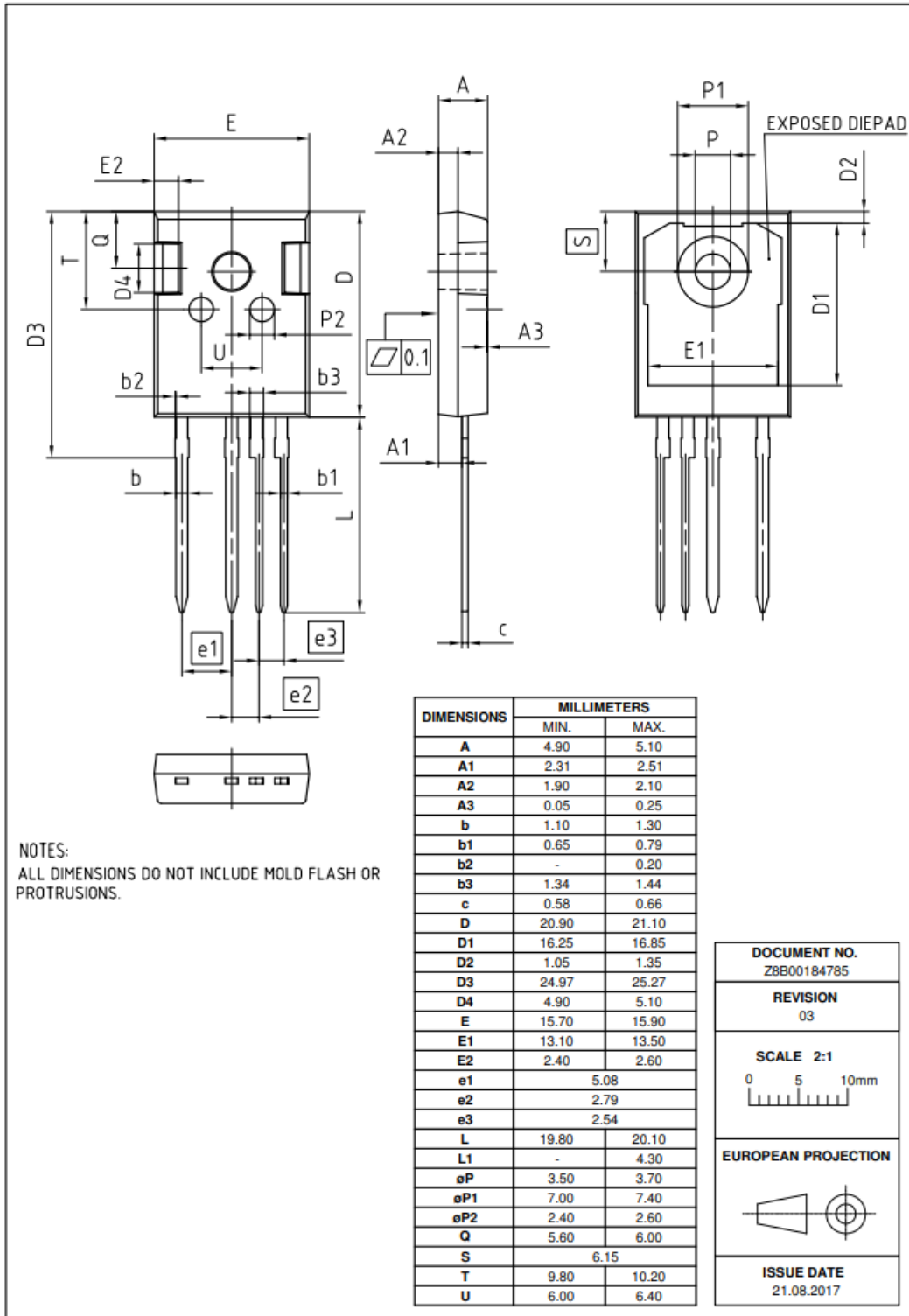


图 1

6 测试条件

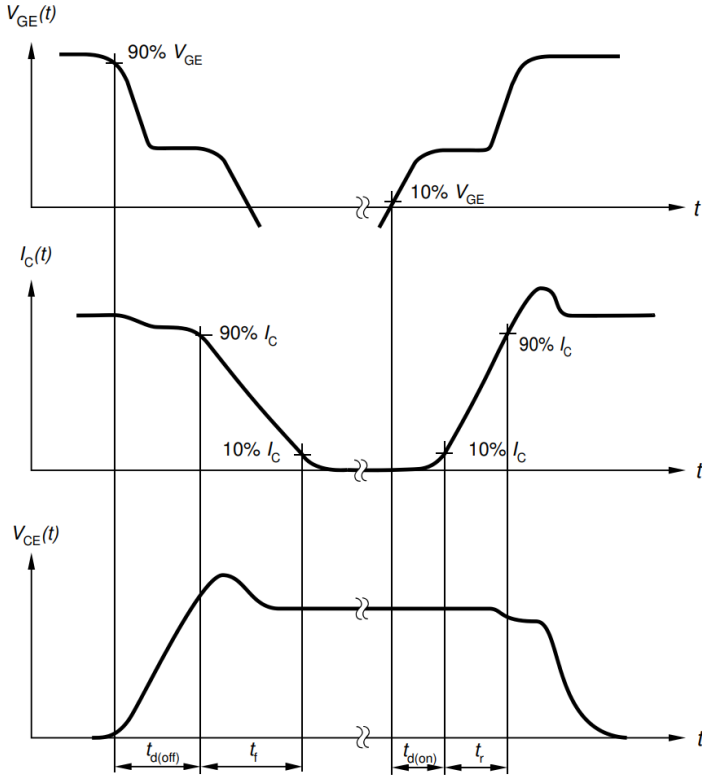


Figure A. Definition of switching times

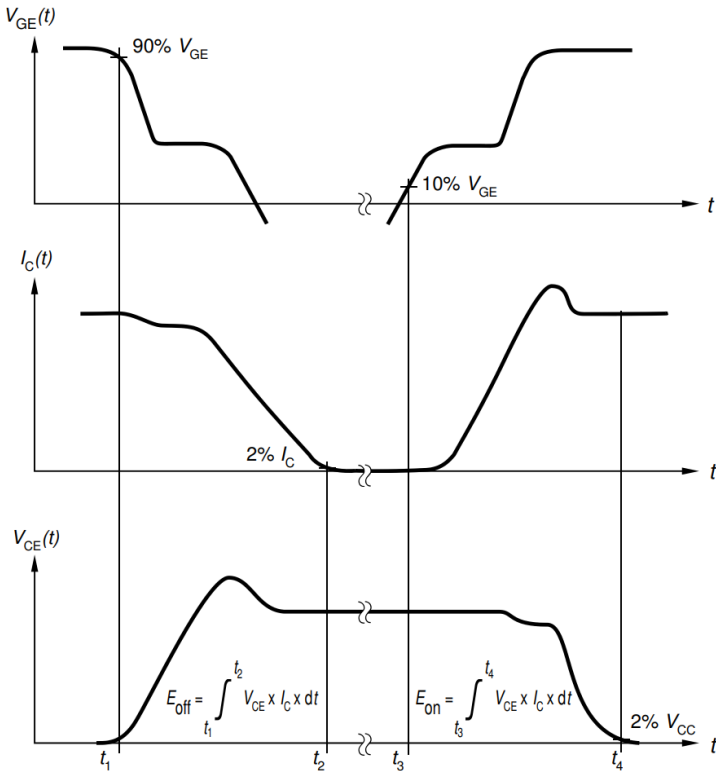


Figure B. Definition of switching losses

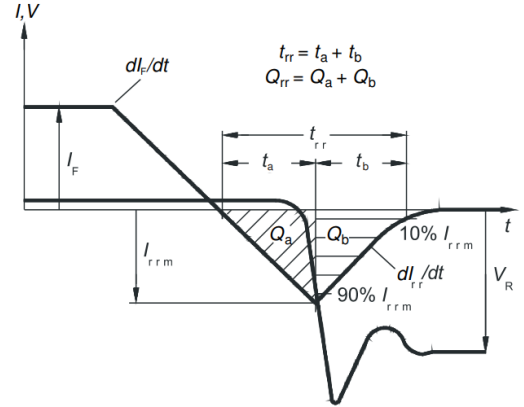


Figure C. Definition of diode switching characteristics

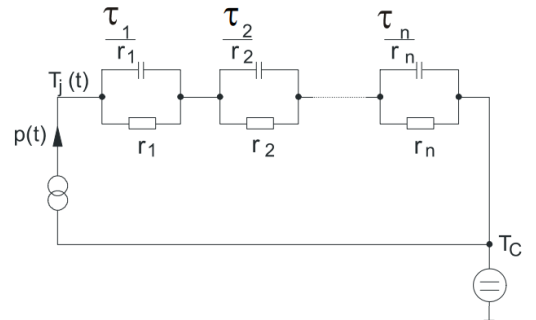


Figure D. Thermal equivalent circuit

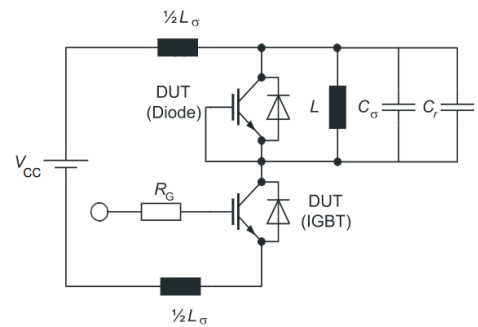


Figure E. **Dynamic test circuit**
Parasitic inductance L_σ ,
parasitic capacitor C_σ ,
relief capacitor C_r ,
(only for ZVT switching)

修订记录

Document revision	Date of release	Description of changes
V1.1	2020-03-20	Preliminary Data Sheet
V2.1	2020-07-27	Final Data Sheet
n/a	2020-11-30	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
1.10	2022-09-22	Rename of product family name from “Hybrid CoolSiC™ IGBT” to “CoolSiC™ hybrid discrete”



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

重要通知

版本 2025-10-30

Infineon Technologies AG 出版，
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2025 Infineon Technologies AG
及其关联公司。
保留所有权利。

**Do you have a question about this
document?**

Email:
erratum@infineon.com

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担不侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文档包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。